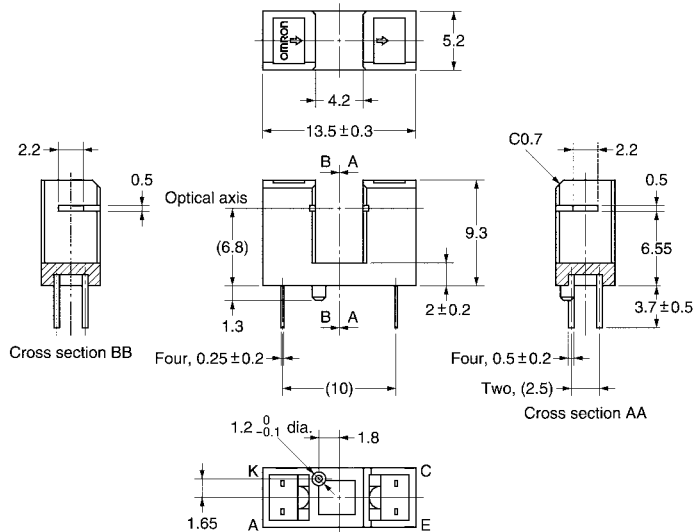


Photomicrosensor (Transmissive) EE-SX1128

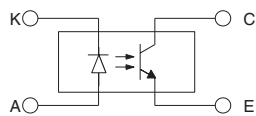
⚠ Be sure to read Precautions on page 25.

■ Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.



Internal Circuit



Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Dimensions	Tolerance
$0 < x \leq 4$	± 0.100
$4 < x \leq 18$	± 0.200

Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
C	Collector
E	Emitter

■ Features

- General-purpose model with a 4.2-mm-wide slot.
- PCB mounting type.
- High resolution with a 0.5-mm-wide aperture.
- Horizontal sensing aperture.

■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	I_F 50 mA (see note 1)
	Pulse forward current	I_{FP} 1 A (see note 2)
	Reverse voltage	V_R 4 V
Detector	Collector–Emitter voltage	V_{CEO} 30 V
	Emitter–Collector voltage	V_{ECO} ---
	Collector current	I_C 20 mA
	Collector dissipation	P_C 100 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	T_{opr} -25°C to 85°C
	Storage	T_{stg} -30°C to 100°C
Soldering temperature	T_{sol}	260°C (see note 3)

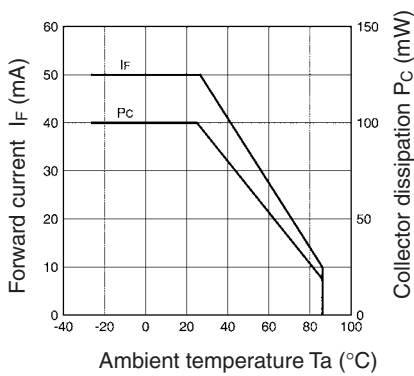
- Note:**
1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.
 2. The pulse width is 10 μ s maximum with a frequency of 100 Hz.
 3. Complete soldering within 10 seconds.

■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)

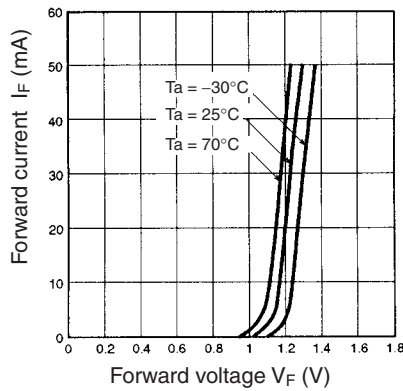
Item	Symbol	Value	Condition
Emitter	Forward voltage	V_F 1.2 V typ., 1.5 V max.	$I_F = 30$ mA
	Reverse current	I_R 0.01 μ A typ., 10 μ A max.	$V_R = 4$ V
	Peak emission wavelength	λ_P 940 nm typ.	$I_F = 20$ mA
Detector	Light current	I_L 0.5 mA min., 10 mA max.	$I_F = 20$ mA, $V_{CE} = 10$ V
	Dark current	I_D 2 nA typ., 200 nA max.	$V_{CE} = 10$ V, 0 lx
	Leakage current	I_{LEAK} ---	---
	Collector–Emitter saturated voltage	$V_{CE(sat)}$ 0.1 V typ., 0.4 V max.	$I_F = 20$ mA, $I_L = 0.1$ mA
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ_P 850 nm typ.	$V_{CE} = 10$ V
Rising time	t_r	4 μ s typ.	$V_{CC} = 5$ V, $R_L = 100$ Ω , $I_L = 5$ mA
Falling time	t_f	4 μ s typ.	$V_{CC} = 5$ V, $R_L = 100$ Ω , $I_L = 5$ mA

Engineering Data

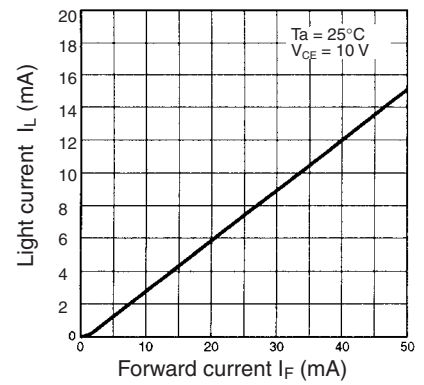
Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating



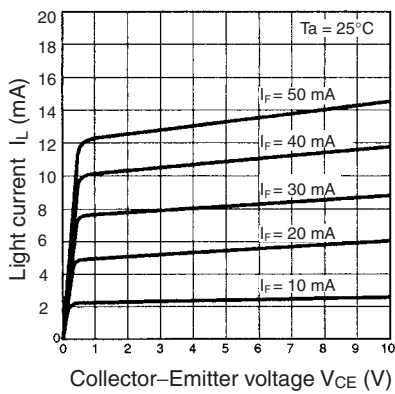
Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics (Typical)



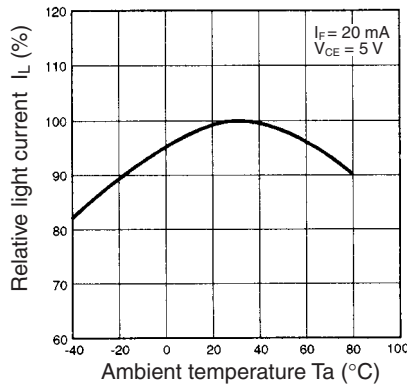
Light Current vs. Forward Current Characteristics (Typical)



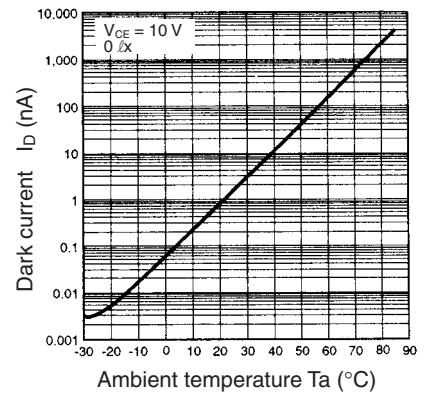
Light Current vs. Collector-Emitter Voltage Characteristics (Typical)



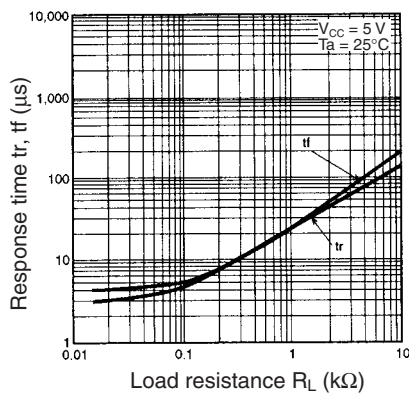
Relative Light Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)



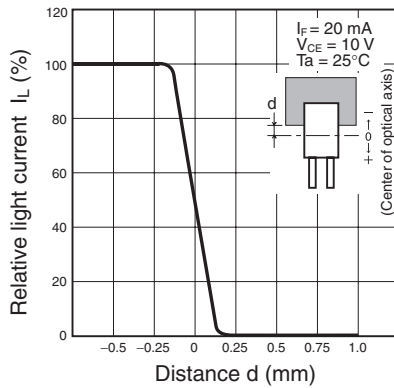
Dark Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)



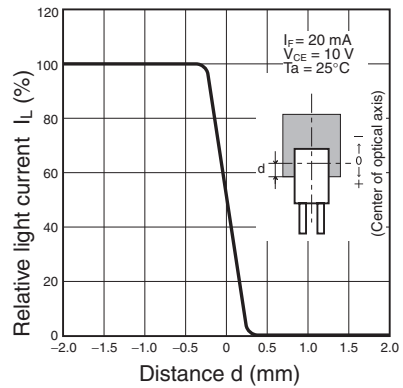
Response Time vs. Load Resistance Characteristics (Typical)



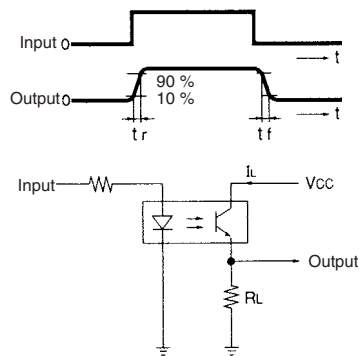
Sensing Position Characteristics (Typical)



Sensing Position Characteristics (Typical)



Response Time Measurement Circuit



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

